時程規劃

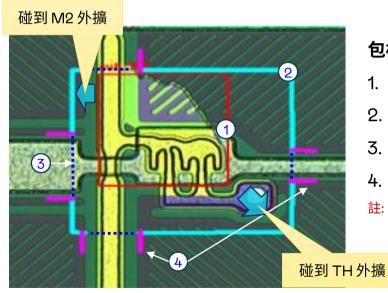
	ArrayAutoRe _l 精簡修法實駅	pair 魚	Resource : MAMC1, 8A Contact Windows : MAMCC1 世恩/仕杰, INT TEST 郭鴻, TaskForce 東義									
	Project Items	Owners	Schedule									
No			W422 5/27~5/31	w423 6/03~6/07	w424 6/11~6/14	w425 6/17~6/21	w426 6/24~6/28	w427 7/01~7/05	w428 7/08~7/12			
	包框維修 模組開發	李恩		帽沿修法			修法結果驗證					
1												
	精簡修法 主流程開發	安廷					模組整合					
2												
3	ZAP 模組調整	威億/浩諶	前後檢核調整	黑核收縮算法調整	樣本功能測試							
4	不規則 CUT調整	威億/浩諶			前後檢核調整	CUT算法調整	樣本功能測試					
4												
5	DP模組調整	安廷			前後檢核調整	DP算法調整 (切脖子判讀)	樣本功能測試					
5												
	程式整合測試	李恩					功能整合		線下驗證結果			
6												



包框修法開發進度



包框演算法邏輯



包框演算法邏輯

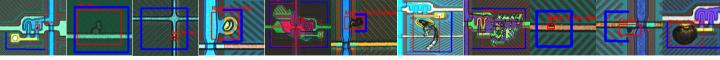
- 1. 前檢核 > 排除邊緣 & 範圍過大的 Defect 框
- 2. 計算包框範圍 > 放大 Defect 框 ,規避重要元件
- 3. 在維修範圍內,將位於重要元件上的維修路徑去除
- 4. 包框帽緣沿重要元件延伸 > 避免切不乾淨

註: 重要元件: M2、GL、TFT、TH



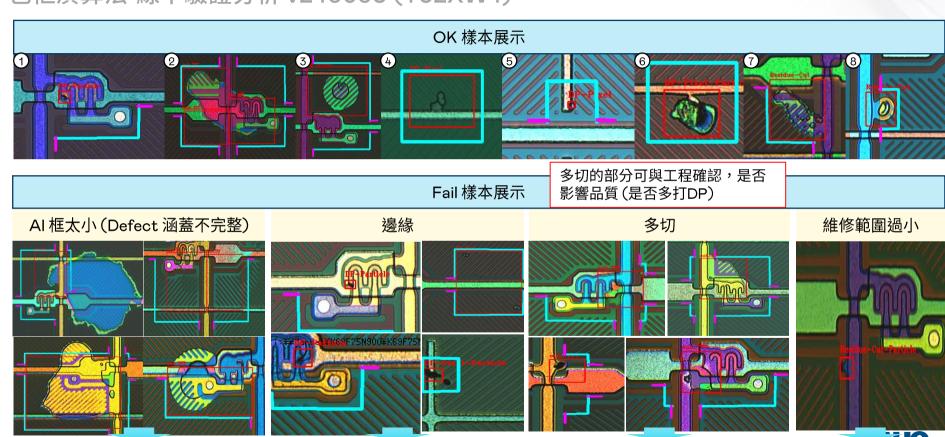
ArrayAutoRepair 精簡修法 包框演算法-線下小量驗證 v240605 (T32XW4)

類別	3	4	8	9	12	13	14	15	17	18	24	Total
總張數	200	14	188	7	62	43	30	40	198	25	21	828
成功張數	194	12	166	7	29	40	17	35	193	20	17	730
失敗張數	6	2	22	0	33	3	13	5	5	5	4	98
AI 框失敗	0	0	0	0	25	0	11	4	0	2	2	44
邊緣失敗	6	2	22	0	3	2	1	1	5	0	2	44
多切失敗	0	0	0	0	5	0	1	0	0	3	0	9
維修成功率 (ALL)	97.00%	85.71%	88.30%	100.00%	46.77%	93.02%	56.67%	87.50%	97.47%	80.00%	80.95%	88.16%
ĺ				0.0.0.0					A COLUMN TO THE OWNER OF THE OWNER		177777	





包框演算法-線下驗證分析 v240605 (T32XW4)



模型調整(框更貼合)

流程判定 -> 二次置中拍照維修

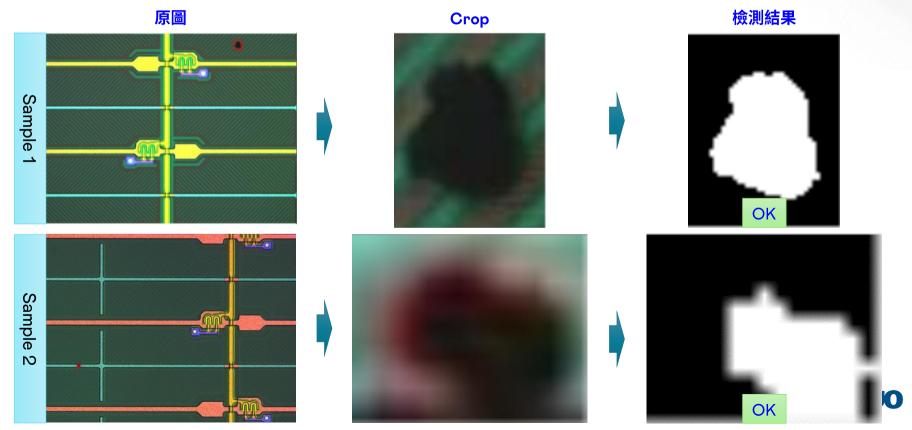
模型調整 (框更貼合)

演算法修改

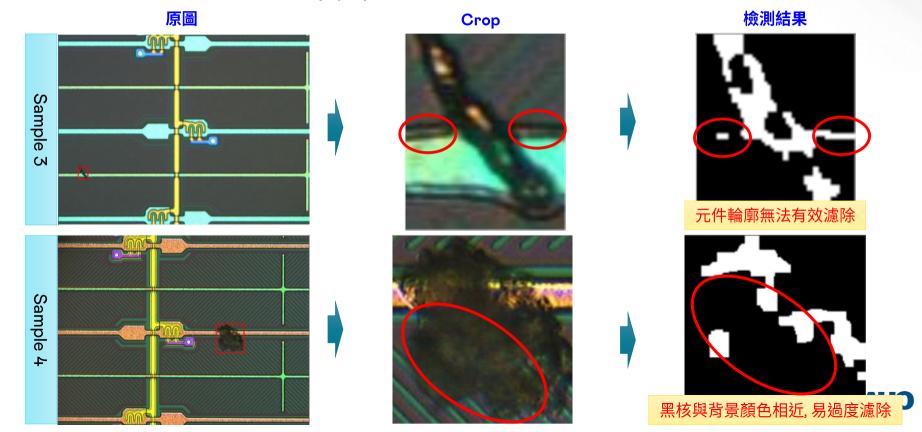
黑核檢測算法開發進度



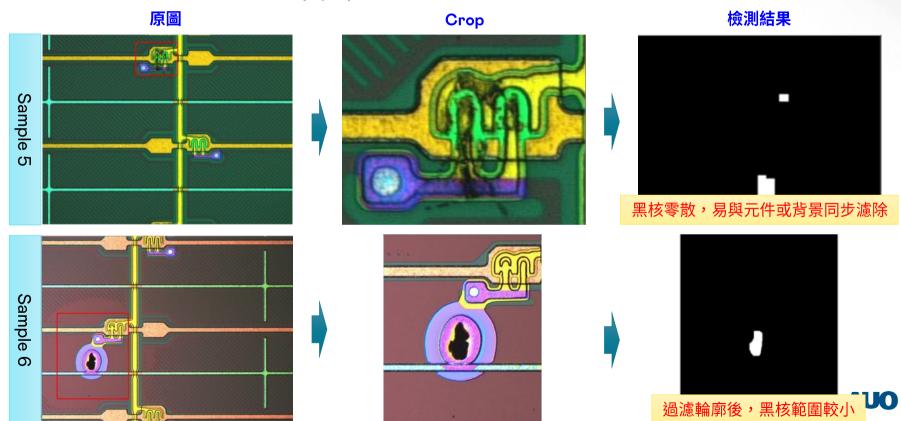
ArrayAutoRepair 精簡修法 黑核檢測演算法結果展示(1/3)



ArrayAutoRepair 精簡修法 黑核檢測演算法結果展示(2/3)



ArrayAutoRepair 精簡修法 黑核檢測演算法結果展示(3/3)

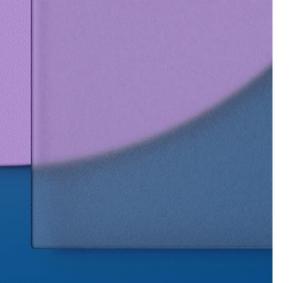


w423 進度小結

- 1. 包框演算法:初版線下小量驗證,維修成功率約88%
 - 待嘗試調整:Defect 框涵蓋不完整、瑕疵邊緣類型、維修範圍過小

- 2. 黑核檢測算法:已能處理黑核顏色平均 & 黑核特徵集中類型
 - 待嘗試調整:元件輪廓過深、黑核與背景顏色相近、黑核特徵零散





Next

- 包框算法調整
- 黑核檢測算法調整
- 包框後檢核功能開發
- 修法主流程調整

Tap Into The Possibilities

